

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

紫光国芯微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240418

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	信达证券、安信基金、宝盈基金、北京清和泉资本、博道基金、博时基金、博众投资、创金合信基金、淳厚基金、大成基金、大朴资产、德邦基金、东吴基金、敦和资产、富安达基金、广东正圆私募基金、广发基金、广发证券、国寿安保、国新证券、海富通券商研究、合远基金、华富基金、华商基金、华泰自营、华夏财富创新投资、华夏基金、华夏未来资本、汇泉基金、汇添富基金、嘉合基金、建信基金、建信理财、交银施罗德基金、金鹰基金、九泰基金、昆仑星河投资、摩根士丹利、南京证券、农银、鹏华投研、平安资管、浦银安盛权益投研、前海开源、上海开思股权投资基金、上海盘京投资、深圳望正资产、太平基金、泰信基金、天风资管、天弘基金、天治基金、万家基金、西部利得基金、信达销售、兴业理财、兴业证券、兴证全球基金、银华基金、永赢基金、友邦保险、于翼资产、源乐晟投研、长城财富资管、招商基金、中国信达、中华联合保险、中加基金、中金半导体、中金基金、中信保诚、中信保诚资管、中信建投资管、中信建投自营、中银基金、中邮人寿等机构。
时间	2024年4月18日（星期四）上午10:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁：谢文刚 副总裁、董事会秘书：杜林虎 财务总监：杨秋平

投资者关系活动
主要内容介绍

一、副董事长、总裁谢文刚针对公司 2023 年度整体情况做介绍

2023年，面对复杂的外部形势和严峻的市场环境，公司保持战略定力、稳中求进，多措并举应对市场挑战，实现了经营业绩的总体稳定。2023年度，公司实现营业收入75.65亿元，较上年同期增长6.26%；实现归属于上市公司股东的净利润25.31亿元，较上年同期下降3.84%。经营活动产生的现金流量净额17.72亿元，较上年同期增长2.63%。截至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产116.54亿元，较上年同期增长20.11%。

主营业务收入中，集成电路业务占比进一步提升，其中特种集成电路业务收入小幅下滑，智能安全芯片收入增长迅速，收入结构发生变化，导致公司综合毛利率小幅下滑，但具体各核心业务的毛利率基本稳定，保持了较好的盈利水平。净利润小幅下滑的主要原因是需求不足。

公司资产负债结构占比平稳，无异常波动，财务状况良好。公司资产负债率33%，较年初下降3个百分点，维持在较低水平，偿债能力强，财务风险很低。

在市场需求不足的情况下，公司一方面努力开拓市场，稳定业绩，同时，苦练内功，持续加大新技术、新产品开发投入，不断提升运营效率、管理效能，综合竞争优势进一步巩固，为公司持续高质量发展奠定了坚实基础。特种集成电路各个系列的新产品研发工作高质量推进，并进一步扩展产品等级，新推出工业级产品系列和耐辐照产品系列。特别是专用处理器产品系列、模拟产品系列都有一批新产品完成研发，开始进入市场推广。智能安全芯片业务，全力拓展海外市场的同时，积极布局汽车电子领域，打造未来利润增长点。

2023年，公司完成董事会换届和管理团队的调整，并对业务体系、管理体系进行梳理完善，进一步聚焦核心主业、优化资源配置、调整组织结构、降低管理成本、提升管理效率。目前，已经完成部分工作，相关工作今年会持续推进。

2024年，内外部市场环境仍然存在诸多不确定性风险，但总体趋稳向好，各主要市场调研机构数据显示，2024年全球半导体行业整体有望重回增长。经过不断的积势蓄力，公司在技术、产品、管理和市场方面都有进一步的改善和提升，为未来的快速发展打下了坚实基础。

2024年，公司将提升公司治理能力和组织效能，科学高效决策，强化风险管控，推进各项工作的持续精进，实现公司稳中有进，进中有质的高质量发展。同时，积极落实“质量回报双提升”

行动方案，持续提升公司内在价值、投资价值，增强投资者回报，与广大投资者共享公司发展成果。

二、问答交流

1、公司特种集成电路业务部分产品价格下降，但毛利率较稳定，公司如何消化降价压力？未来特种集成电路价格走势如何？

答：特种行业下游需求放缓，行业竞争加剧，产品价格有一定压力，公司在这样的市场环境下，仍保持了较好的毛利率水平，与近些年的管理效率和能效的提升有很大关联。公司在能效、自动化、信息化建设等方面做了大量工作，产品良率和规模方面有很好的提升，积极应对市场降价的风险，保持住了较好的毛利率状态。未来，公司将进一步加强上述各方面工作，提升人效和能效是公司长期经营管理目标。

特种行业领域有特定需求，价格不是最核心因素，长远看，市场对产品价格和质量有双重要求。在经过一定降价后，质量将重新成为关键因素，从而压缩降价空间。即使在高度市场竞争的通用产品市场中，如果公司运营良好，仍能保持较高毛利率水平，公司对未来的盈利能力充满信心。

2、公司在特种集成电路领域研发投入的重点方向有哪些？

答：公司是以平台化角色参与市场，目前在数字电路领域中，绝大多数产品方向都已经具备基础能力，在需要投入较大科研力量和较长时间的 DSP 产品方面，通过与科研机构合作和公司自身投入，已经推出具有行业竞争力的产品，或将是未来新的增长点。此外，近年来，公司在模拟电路和信号链领域做了扎实储备，今年将在隔离、电源、高性能频率器件、谐振器、时钟发生器等方向上不断推出新产品。未来，公司在多品种、多系列、多门类的发展中将会不断推出新产品，持续提高为特种行业提供“超市型”高质量产品和服务的供应保障能力。

3、公司特种集成电路产品未来长期毛利率目标是什么？是否存在当产品毛利率低于某水平线后不做情况？

答：特种行业有一定非经济因素的考量，通常需要给客户稳定的供应保障，一般情况下不会出现退出市场的情况。公司在特种行业的规模效应决定了在相同条件下，公司的竞争力和毛利率水平将高于同行业友商。因此，即使竞争达到一定激烈程度后，公司仍可维持有效的毛利率水平。未来，公司在规模、技术储备、研发投入、产品质量等方面的竞争优势会进一步体现。

4、公司目前的订单情况如何？

答：目前下游需求还没有出现整体根本性好转，但不同领域、不同用户在需求方面有起伏变化。经过去年一年的调整，今年特种领域相关建设工作应该会重新启动，国家经济预算、相关投入和需求一直存在，公司希望细分行业能尽快走出这个过渡阶段，实现整个行业的较大回升。

5、行业内公司已推出 10 亿门级、1xnm 制程的 FPGA, 公司在较先进制程的 FPGA 领域是否有布局？

答：公司也已经推出同类产品，与行业内公司基本同步。目前，该产品已在用户端进行多轮试验，相关用户反馈信息良好，希望该产品可以成为公司今年新的增长点。当然，新产品的转批产会有一定过程。

6、公司产品是否受惠于低空经济领域的发展？

答：公司在特种领域是应用量最大、门类最多的芯片供应商之一，在 C919 飞机上有一颗经过试航认证的总线交换芯片产品。低空经济仍处于起步阶段，目前无法清晰判断其对器件的需求和要求，如果相关领域有机会，公司具备很大的先决条件。

7、公司未来研发费用的趋势如何？

答：公司近年研发费用在总费用的占比都超过 60%，2023 年研发费用占营业收入比例达 21.6%，预计未来这个比例也不会低于 20%。公司作为高科技企业，科研投入和新产品开发是经营发展的关键因素，在竞争激烈的相关环节，科研、人才、资金投入是保障技术领先的根本，公司会继续保持较高的研发投入，确保公司产品和技术的领先，不断提升公司的市场竞争力。

8、公司股权激励的进度情况？

答：公司在 2024 年 3 月底推出股份回购方案，并于当年 7 月完成总金额 6 亿元的股份回购工作，计划用于股权激励或员工持股计划。由于时间较为紧张，未能在 2023 年 9 月 30 日前及时推出方案。因此，计划本次 2023 年度报告披露后，继续完善激励方案，争取尽快推出相关方案并落地实施。

9、公司 AI 相关产品情况，以及未来在该领域的布局情况？

答：公司特种集成电路业务在多年前已介入 AI 领域，曾根据用户需求，研发过一颗特种 AI 芯片，取得较好效果。目前，整体看特种 AI 芯片在下游应用的需求处于动态变化过程，尚未达到稳定状态，公司始终密切关注相关领域技术发展，保持对最前沿 AI 技术的跟踪，结合下游需求开展研究。目前，AI 相关产品未对公

司业绩产生实质性影响，后续一旦出现大规模应用需求，公司可以第一时间推出合适产品。

10、智能安全芯片业务海外需求情况？

答：公司的智能安全芯片业务在国内外始终保持在第一梯队，随着国际形势变化和竞争加剧，一些竞争对手逐步退出某些细分领域，为公司海外市场的拓展提供大量机会和空间，因此，公司2023年在海外市场的业绩出现大幅增长。未来随着公司海外业务的进一步扩充，仍会对公司整体业绩提供很好支撑。

11、公司如何看待汽车电子的机会？公司的主要优势在哪里？

答：公司已在汽车电子领域开展多年的研究工作，已经开发了一颗非常优秀的芯片产品应用于汽车的域控制器，为业务的发展打下了较好的产品和技术基础。随着汽车电子的发展，公司和国内外汽车厂商进行接触，很多客户表现出较大兴趣。同时，公司在智能芯片领域有大量安全性、可靠性的技术、资质积累，在汽车领域也得到了客户认同。

中国新能源汽车在全球快速发展，对相关产品国产化需求有战略性布局和规划，为公司提供了较好的机会。相关客户有防范供应链风险的需求。尽管公司在汽车电子领域的相关业务尚未产生实质上的业绩贡献，但未来的优势会逐步体现出来，成为公司新的增长点。

12、公司业务结构、管理层和股权调整的目标？

答：2023年，公司新管理层上任后，对整体业务进行梳理，明确上市公司总部和各业务子公司的分工，以及各部门、各业务子公司之间的决策流程、业务重点、资源投入等。2023年，公司对一些亏损严重、商业逻辑无竞争优势的公司进行清算，对不具备竞争力、没有达到预期的相关产品进行清退。通过内部梳理、调整和优化，对公司的运营状态、在行业中的定位和未来发展方向的规划提供强有力的支撑。

公司管理层整体的想法是：一、专业的人做专业的事；二、在共同目标和发展前景下，责任和业绩层层分担；三、进一步明确和清晰认知公司的运营状态以及在行业中的位置。公司将进一步加强上述三个方面的工作，保持健康发展态势，不断提升竞争优势。

13、公司在特种集成电路芯片和智能安全芯片研发投入的占比？

答：2023年，由于智能安全芯片板块在汽车电子方向的投入，其研发投入占比略高于特种集成电路板块。未来，预计公司在这两大核心业务板块的研发投入将基本持平。

	<p>公司在高水平技术方向的研究和高素质人才的吸引上始终保持不设限的状态，在相关具有前景的技术方向，将始终保持高比例、高强度的投入。相信经过持续高强度投入，将会对公司核心竞争力的提升有更为明显的支撑。</p> <p>14、公司 2023 年的分红金额比往年多，未来公司将如何平衡业务发展和股东回报的关系？</p> <p>答：公司已经披露 2023 年度利润分配预案，现金分红总额占 2023 年度合并财务报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 22.66%。根据监管部门鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合公司 2023 年的经营业绩，公司年度的现金分红比例提升较多。同时，作为芯片设计公司，需要较高的研发投入和资金需求，以保持公司的技术先进性和行业竞争力，特别在行业景气度下降情况下，公司需要有一定安全资金储备。本次现金分红方案基本统筹平衡了公司的长远稳健发展和股东较高的即期回报。公司在 2023 年实施的总金额 6 亿元的股份回购及本次推出的年度 5.73 亿元现金分红预案，旨在努力提升投资者的获得感，提高对广大投资者的回报水平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 4 月 18 日